

目次

1. パッケージビジネスの現状と展望

1-1 パッケージビジネスの現状と展望	2
1-1-1 世界半導体産業の売上推移と展望	3
1-1-2 世界半導体後工程市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	3
1-1-3 世界パッケージ市場・世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望 "	4
1-1-4 世界 OSAT 上位 20 社の売上推移と展望	4
1-1-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別売上一覧	5
1-1-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別社数構成比	6
1-1-7 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別売上構成比 (2024 年度)	6
1-2 後工程製造拠点および設備投資状況	7
1-2-1 後工程工場世界分布 (日本を除く)	8
1-2-2 世界 OSAT 上位 20 社の後工程工場世界分布 (日本を除く) "	8
1-2-3 世界半導体設備投資の推移と展望	9
1-2-4 世界半導体後工程設備投資の推移と展望	9
1-2-5 世界 OSAT 上位 20 社の企業別後工程設備投資一覧	10
1-2-6 世界 OSAT 上位 20 社の国籍別設備投資構成比 (2024 年度)	10
1-3-1 半導体後工程市場の現状と展望 - 日本	11
1-3-1-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 日本	12
1-3-1-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 日本	13
1-3-2 半導体後工程市場の現状と展望 - 台湾	14
1-3-2-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 台湾	15
1-3-2-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 台湾	16
1-3-3 半導体後工程市場の現状と展望 - 韓国	17
1-3-3-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 韓国	18
1-3-3-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 韓国	19
1-3-4 半導体後工程市場の現状と展望 - 中国	20
1-3-4-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 中国	21
1-3-4-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 中国	22
1-3-5 半導体後工程市場の現状と展望 - 東南アジア	23
1-3-5-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 東南アジア	24
1-3-5-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 東南アジア	25
1-3-6 半導体後工程市場の現状と展望 - 米国	26
1-3-6-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 米国	27
1-3-6-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 米国	28
1-3-7 半導体後工程市場の現状と展望 - 欧州	29
1-3-7-1 半導体後工程の企業別売上一覧 - 欧州	30
1-3-7-2 半導体後工程の企業別設備投資一覧 - 欧州	31

2. 国内半導体企業のパッケージ事業戦略

2-1 ソニー株式会社	34
1) 事業戦略	34
2) 設備投資	35
3) 開発と今後の方向性	36
4) 半導体売上状況	37
5) 設備投資状況	37
6) 工場別提供パッケージ	38
7) 各工場のライン別一覧	39
2-2 ルネサスエレクトロニクス株式会社	43
1) 事業戦略	43
2) 設備投資	44
3) 開発と今後の方向性	45
4) 半導体売上状況	46

5) 設備投資状況	46
6) 工場別提供パッケージ	47
7) 各工場のライン別一覧	48
2-3 東芝デバイス & ストレージ株式会社	56
1) 事業戦略	56
2) 設備投資	57
3) 開発と今後の方向性	57
4) 半導体売上状況	59
5) 設備投資状況	59
6) 工場別提供パッケージ	60
7) 各工場のライン別一覧	61
2-4 ローム株式会社	66
1) 事業戦略	66
2) 設備投資	67
3) 開発と今後の方向性	67
4) 半導体売上状況 - (1) 全社製品別	69
4) 半導体売上状況 - (2) 後工程関連	69
5) 設備投資状況 - (1) 全社製品別	70
5) 設備投資状況 - (2) 後工程関連	70
6) 工場別提供パッケージ	71
7) 各工場のライン別一覧	72
2-5 三菱電機株式会社	83
1) 事業戦略	83
2) 設備投資	84
3) 開発と今後の方向性	84
4) 半導体売上状況	86
5) 設備投資状況	86
6) 工場別提供パッケージ	87
7) 各工場のライン別一覧	88
2-6 富士電機株式会社	96
1) 事業戦略	96
2) 設備投資	96
3) 開発と今後の方向性	97
4) 半導体売上状況	98
5) 設備投資状況	98
6) 工場別提供パッケージ	99
7) 各工場のライン別一覧	100
2-7 ミネベアミツミ株式会社	107
1) 事業戦略	107
2) 設備投資	108
3) 開発と今後の方向性	109
4) 半導体売上状況	110
5) 設備投資状況	110
6) 工場別提供パッケージ	111
7) 各工場のライン別一覧	112
2-8 サンケン電気株式会社	117
1) 事業戦略	117
2) 設備投資	118
3) 開発と今後の方向性	118
4) 半導体売上状況	120
5) 設備投資状況	120
6) 工場別提供パッケージ	121
7) 各工場のライン別一覧	122
2-9 浜松ホトニクス株式会社	128
1) 事業戦略	128
2) 設備投資	128
3) 開発と今後の方向性	129
4) 半導体売上状況	130
5) 設備投資状況	130
6) 工場別提供パッケージ	131
7) 各工場のライン別一覧	132

Semiconductor Package Business Strategy 2026

2-10 日清紡マイクロデバイス株式会社	137	1) 事業戦略	190
1) 事業戦略	137	2) 設備投資	192
2) 設備投資	138	3) 開発と今後の方向性	192
3) 開発と今後の方向性	138	4) 半導体売上状況	195
4) 半導体売上状況	139	5) 設備投資状況	195
5) 設備投資状況	139	6) 工場別提供パッケージ	196
6) 工場別提供パッケージ	140	7) 各工場のライン別一覧	197
7) 各工場のライン別一覧	141	3-2 Micron Technology	203
2-11 コーデンシ株式会社	143	1) 事業戦略	203
1) 事業戦略	143	2) 設備投資	204
2) 設備投資	144	3) 開発と今後の方向性	205
3) 開発と今後の方向性	144	4) 半導体売上状況	206
4) 半導体売上状況	145	5) 設備投資状況	206
5) 設備投資状況	145	6) 工場別提供パッケージ	207
6) 工場別提供パッケージ	146	7) 各工場のライン別一覧	208
7) 各工場のライン別一覧	147	3-3 Texas Instruments	214
2-12 セイコーエプソン株式会社	151	1) 事業戦略	214
1) 事業戦略	151	2) 設備投資	215
2) 設備投資	151	3) 開発と今後の方向性	216
3) 開発と今後の方向性	152	4) 半導体売上状況	217
4) 半導体売上状況	153	5) 設備投資状況	217
5) 設備投資状況	153	6) 工場別提供パッケージ	218
6) 工場別提供パッケージ	154	7) 各工場のライン別一覧	219
7) 各工場のライン別一覧	155	3-4 ON Semiconductor	225
2-13 新電元工業株式会社	158	1) 事業戦略	225
1) 事業戦略	158	2) 設備投資	226
2) 設備投資	158	3) 開発と今後の方向性	227
3) 開発と今後の方向性	159	4) 半導体売上状況	228
4) 半導体売上状況	160	5) 設備投資状況	228
5) 設備投資状況	160	6) 工場別提供パッケージ	229
6) 工場別提供パッケージ	161	7) 各工場のライン別一覧	230
7) 各工場のライン別一覧	162	3-5 Analog Devices	241
2-14 スタンレー電気株式会社	169	1) 事業戦略	241
1) 事業戦略	169	2) 設備投資	242
2) 設備投資	170	3) 開発と今後の方向性	242
3) 開発と今後の方向性	170	4) 半導体売上状況	244
4) 半導体売上状況	171	5) 設備投資状況	244
5) 設備投資状況	171	6) 工場別提供パッケージ	245
6) 工場別提供パッケージ	172	7) 各工場のライン別一覧	246
7) 各工場のライン別一覧	173	3-6 Samsung Electronics	249
2-15 デクセリアルズ株式会社	177	1) 事業戦略	249
1) 事業戦略	177	2) 設備投資	250
2) 設備投資	178	3) 開発と今後の方向性	251
3) 開発と今後の方向性	178	4) 半導体売上状況	253
4) 半導体売上状況	179	5) 設備投資状況	253
5) 設備投資状況	179	6) 工場別提供パッケージ	254
6) 工場別提供パッケージ	180	7) 各工場のライン別一覧	255
7) 各工場のライン別一覧	181	3-7 SK Hynix	259
2-16 株式会社オリジン	184	1) 事業戦略	259
1) 事業戦略	184	2) 設備投資	260
2) 設備投資	184	3) 開発と今後の方向性	261
3) 開発と今後の方向性	185	4) 半導体売上状況	262
4) 半導体売上状況	186	5) 設備投資状況	262
5) 設備投資状況	186	6) 工場別提供パッケージ	263
6) 工場別提供パッケージ	187	7) 各工場のライン別一覧	264
7) 各工場のライン別一覧	188	3-8 TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation)	267
3. 海外半導体企業のパッケージ事業戦略		1) 事業戦略	267
3-1 Intel Corporation	190	2) 設備投資	268
		3) 開発と今後の方向性	268
		4) 半導体売上状況	271

5) 設備投資状況	271	6) 工場別提供パッケージ	348
6) 工場別提供パッケージ	272	7) 各工場のライン別一覧	349
7) 各工場のライン別一覧	273	4-5 エスタカヤ電子工業株式会社	353
3-9 Infineon Technologies	280	1) 事業戦略	353
1) 事業戦略	280	2) 設備投資	353
2) 設備投資	281	3) 開発と今後の方向性	353
3) 開発と今後の方向性	282	4) 半導体売上状況	355
4) 半導体売上状況	285	5) 設備投資状況	355
5) 設備投資状況	285	6) 工場別提供パッケージ	356
6) 工場別提供パッケージ	286	7) 各工場のライン別一覧	357
7) 各工場のライン別一覧	287	4-6 株式会社ミスズ工業	358
3-10 STMicroelectronics	297	1) 事業戦略	358
1) 事業戦略	297	2) 設備投資	358
2) 設備投資	298	3) 開発と今後の方向性	358
3) 開発と今後の方向性	299	4) 半導体売上状況	359
4) 半導体売上状況	301	5) 設備投資状況	359
5) 設備投資状況	301	6) 工場別提供パッケージ	360
6) 工場別提供パッケージ	302	7) 各工場のライン別一覧	361
7) 各工場のライン別一覧	303	4-7 東洋電子工業株式会社	363
3-11 NXP Semiconductors	312	1) 事業戦略	363
1) 事業戦略	312	2) 設備投資	363
2) 設備投資	313	3) 開発と今後の方向性	364
3) 開発と今後の方向性	313	4) 半導体売上状況	365
4) 半導体売上状況	315	5) 設備投資状況	365
5) 設備投資状況	315	6) 工場別提供パッケージ	366
6) 工場別提供パッケージ	316	7) 各工場のライン別一覧	367
7) 各工場のライン別一覧	317	4-8 大津電子株式会社	368
		1) 事業戦略	368
		2) 設備投資	368
		3) 開発と今後の方向性	368
		4) 半導体売上状況	369
		5) 設備投資状況	369
		6) 工場別提供パッケージ	370
		7) 各工場のライン別一覧	371
		4-9 九州日誠電気株式会社	372
		1) 事業戦略	372
		2) 設備投資	372
		3) 開発と今後の方向性	372
		4) 半導体売上状況	373
		5) 設備投資状況	373
		6) 工場別提供パッケージ	374
		7) 各工場のライン別一覧	375
		4-10 株式会社野田市電子	376
		1) 事業戦略	376
		2) 設備投資	376
		3) 開発と今後の方向性	376
		4) 半導体売上状況	377
		5) 設備投資状況	377
		6) 工場別提供パッケージ	378
		7) 各工場のライン別一覧	379
4. 国内 OSAT 企業のパッケージ事業戦略			
4-1 アオイ電子株式会社	322		
1) 事業戦略	322		
2) 設備投資	323		
3) 開発と今後の方向性	323		
4) 半導体売上状況	324		
5) 設備投資状況	324		
6) 工場別提供パッケージ	325		
7) 各工場のライン別一覧	326		
4-2 新光電気工業株式会社	332		
1) 事業戦略	332		
2) 設備投資	333		
3) 開発と今後の方向性	333		
4) 半導体売上状況	334		
5) 設備投資状況	334		
6) 工場別提供パッケージ	335		
7) 各工場のライン別一覧	336		
4-3 株式会社加藤電器製作所	337		
1) 事業戦略	337		
2) 設備投資	338		
3) 開発と今後の方向性	338		
4) 半導体売上状況	339		
5) 設備投資状況	339		
6) 工場別提供パッケージ	340		
7) 各工場のライン別一覧	341		
4-4 エムテックスマツムラ株式会社	345		
1) 事業戦略	345		
2) 設備投資	346		
3) 開発と今後の方向性	346		
4) 半導体売上状況	347		
5) 設備投資状況	347		
5. 海外 OSAT 企業のパッケージ事業戦略			
5-1 ASE (Advanced Semiconductor Engineering)	382		
1) 事業戦略	382		
2) 設備投資	383		
3) 開発と今後の方向性	384		
4) 半導体売上状況	386		
5) 設備投資状況	386		
6) 工場別提供パッケージ	387		

Semiconductor Package Business Strategy 2026

7) 各工場のライン別一覧	388	4) 半導体売上状況	529
5-2 Amkor Technology	413	5) 設備投資状況	529
1) 事業戦略	413	6) 工場別提供パッケージ	530
2) 設備投資	414	7) 各工場のライン別一覧	531
3) 開発と今後の方向性	415	5-10 Chipbond Technology	536
4) 半導体売上状況	418	1) 事業戦略	536
5) 設備投資状況	418	2) 設備投資	537
6) 工場別提供パッケージ	419	3) 開発と今後の方向性	538
7) 各工場のライン別一覧	420	4) 半導体売上状況	539
5-3 JCET Group	441	5) 設備投資状況	539
1) 事業戦略	441	6) 工場別提供パッケージ	540
2) 設備投資	442	7) 各工場のライン別一覧	541
3) 開発と今後の方向性	443	5-11 SFA Semicon	549
4) 半導体売上状況	445	1) 事業戦略	549
5) 設備投資状況	445	2) 設備投資	550
6) 工場別提供パッケージ	446	3) 開発と今後の方向性	550
7) 各工場のライン別一覧	447	4) 半導体売上状況	552
5-4 Tongfu Microelectronics (通富微电子)	454	5) 設備投資状況	552
1) 事業戦略	454	6) 工場別提供パッケージ	553
2) 設備投資	455	7) 各工場のライン別一覧	554
3) 開発と今後の方向性	456	5-12 Nepes	557
4) 半導体売上状況	457	1) 事業戦略	557
5) 設備投資状況	457	2) 設備投資	558
6) 工場別提供パッケージ	458	3) 開発と今後の方向性	559
7) 各工場のライン別一覧	459	4) 半導体売上状況	560
5-5 Powertech Technology	469	5) 設備投資状況	560
1) 事業戦略	469	6) 工場別提供パッケージ	561
2) 設備投資	470	7) 各工場のライン別一覧	562
3) 開発と今後の方向性	471	5-13 Formosa Advanced Technologies (FATC)	568
4) 半導体売上状況	473	1) 事業戦略	568
5) 設備投資状況	473	2) 設備投資	569
6) 工場別提供パッケージ	474	3) 開発と今後の方向性	569
7) 各工場のライン別一覧	475	4) 半導体売上状況	570
5-6 Tianshui Huatian Technology (TSHT)	487	5) 設備投資状況	570
1) 事業戦略	487	6) 工場別提供パッケージ	571
2) 設備投資	488	7) 各工場のライン別一覧	572
3) 開発と今後の方向性	489	5-14 Carsem	573
4) 半導体売上状況	490	1) 事業戦略	573
5) 設備投資状況	490	2) 設備投資	574
6) 工場別提供パッケージ	491	3) 開発と今後の方向性	574
7) 各工場のライン別一覧	492	4) 半導体売上状況	576
5-7 UTAC	502	5) 設備投資状況	576
1) 事業戦略	502	6) 工場別提供パッケージ	577
2) 設備投資	503	7) 各工場のライン別一覧	578
3) 開発と今後の方向性	504	5-15 OSE (Orient Semiconductor Electronics)	581
4) 半導体売上状況	506	1) 事業戦略	581
5) 設備投資状況	506	2) 設備投資	582
6) 工場別提供パッケージ	507	3) 開発と今後の方向性	582
7) 各工場のライン別一覧	508	4) 半導体売上状況	583
5-8 ChipMOS Technologies	517	5) 設備投資状況	583
1) 事業戦略	517	6) 工場別提供パッケージ	584
2) 設備投資	517	7) 各工場のライン別一覧	585
3) 開発と今後の方向性	518	5-16 Walton Advanced Engineering	586
4) 半導体売上状況	520	1) 事業戦略	586
5) 設備投資状況	520	2) 設備投資	587
6) 工場別提供パッケージ	521	3) 開発と今後の方向性	587
7) 各工場のライン別一覧	522	4) 半導体売上状況	588
5-9 HANA Micron	526	5) 設備投資状況	588
1) 事業戦略	526	6) 工場別提供パッケージ	589
2) 設備投資	527	7) 各工場のライン別一覧	590
3) 開発と今後の方向性	528	5-17 China Wafer Level CSP	596

1) 事業戦略	596
2) 設備投資	597
3) 開発と今後の方向性	597
4) 半導体売上状況	598
5) 設備投資状況	598
6) 工場別提供パッケージ	599
7) 各工場のライン別一覧	600
5-18 Suzhou Good-Ark Electronics	602
1) 事業戦略	602
2) 設備投資	603
3) 開発と今後の方向性	603
4) 半導体売上状況	604
5) 設備投資状況	604
6) 工場別提供パッケージ	605
7) 各工場のライン別一覧	606
5-19 Signetics	610
1) 事業戦略	610
2) 設備投資	610
3) 開発と今後の方向性	611
4) 半導体売上状況	612
5) 設備投資状況	612
6) 工場別提供パッケージ	613
7) 各工場のライン別一覧	614